

奇景光電收購美國先進奈米3D模具資產及相關智慧財產權和業務

【台南，2018年1月29日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（29）日宣布，將從一家美國高科技公司，收購先進的奈米3D模具製造設備資產，及相關的智慧財產權和業務。該交易預計將於2018年2月完成。但交易細節不對外公開。

該先進奈米3D模具製造技術，主要用於奈米轉印模具或奈米壓印製程，以製造如繞射光學元件（Diffractive Optics Element, DOE）、導光元件（diffuser）、準直透鏡（collimator lens）及陣列式微透鏡（micro lens array）等裝置。此次收購，將為奇景帶來最上游的奈米模具製造能力，更加強化了奇景在全球已經領先的晶圓級光學技術（wafer level optics, WLO），而晶圓級光學技術是奇景目前主推的3D感測整體解決方案的關鍵技術之一。此外，此次收購中，奇景取得高精密灰階光罩和陣列式微透鏡相關的智慧財產權，將為奇景帶來進入生物醫學、演算式照相機、利基型微型顯示器等創新技術領域的未來商機，並得以開發更先進複雜的繞射光學元件和導光元件，以利提供未來世代3D感測解決方案。

為了此次收購，奇景已經成立獨資的子公司 Himax IGI Precision Ltd.（“Himax IGI”）。位於美國明尼蘇達州明尼阿波里斯市的 Himax IGI，將繼續投資開發最先進的奈米3D模具技術和解決方案。另一方面，Himax IGI 具有美國在地的額外優勢，對許多奇景在美國以技術突破為導向的客戶來說，勢必樂見有一個強大而且在地、可以進行早期研發合作的策略夥伴。

奇景光電執行長吳炳昌表示，隨著此次收購而加入奇景團隊的美國新成員，均為此領域的頂尖專家，在微細且技術上深具挑戰性的奈米3D模具領域，可說是世界上最優秀的人才。在過去，奇景團隊有時會對於WLO產品開發過程中不夠完美的部份感到困惑，因為不確定問題是起因於模具的品質，或是自己的產品設計或製造。此次收購，為奇景帶來世界最強的相關模具製造工藝，我們將可以更加提升整體WLO產品品質，並可縮短開發週期。相信我們許多創新導向的客戶，對於此次收購都會同感振奮，因為終於有人做了對的決定，將高精密結構光學產品的奈米3D模具製造、設計及生產，都整合在同一個屋簷下進行。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,150 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2017 年 12 月 31 日為止，奇景光電在全球已取得 3,032 項專利，尚有 424 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
Greg Falesnik, Managing Director
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
Email: greg.falesnik@mzgroup.us
www.mzgroup.us

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2016 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。